

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international(43) Date de la publication internationale
29 juillet 2004 (29.07.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/063817 A1(51) Classification internationale des brevets⁷ :
G03F 7/095, 7/00, B81B 1/00.Saint-Egreve (FR). **BABLET, Jacqueline** [FR/FR];
56, avenue du Vercors, F-38450 Le Gua (FR).(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2003/003788(74) Mandataire : **HECKE, Gérard/JOUVRAY, Marie-An-**
drée; Cabinet Hecke, WTC Europole, 5, place Robert
Schuman, Boîte postale 1537, F-38025 Grenoble Cedex 1
(FR).(22) Date de dépôt international :
18 décembre 2003 (18.12.2003)(81) État désigné (*national*) : US.

(25) Langue de dépôt : français

(84) États désignés (*régional*) : brevet européen (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
02/16272 20 décembre 2002 (20.12.2002) FR

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) : **COM-**
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR];
31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris (FR).

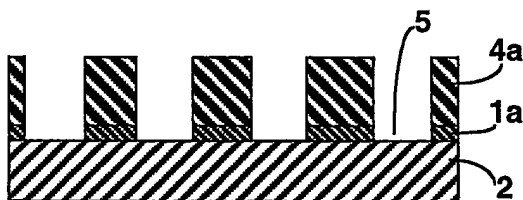
En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (*pour US seulement*) : **RABAROT,**
Marc [FR/FR]; 3, rue Casimir Brenier, F-38120

(54) Title: MICROSTRUCTURE COMPRISING AN ADHESIVE COATING AND METHOD FOR MAKING SAME

(54) Titre : MICROSTRUCTURE COMPORTANT UNE COUCHE D'ADHERENCE ET PROCEDE DE FABRICATION D'UNE TELLE MICROSTRUCTURE



(57) Abstract: The invention concerns a microstructure comprising an adhesive coating (1) between a substrate (2) and a photostructurable coating (4), arranged on at least one surface of the substrate (2). The adhesive coating (1) is photosensitive and consists of a negative resin comprising at least one polymer of the family of elastomers and at least one photoinitiator, in solution in an aromatic solvent. The photostructurable coating (4) consists of at least one negative epoxy resin. The method for making such a microstructure comprises spreading and drying the adhesive

coating (1) prior to depositing the photostructurable coating (4). The adhesive coating (1) can be exposed through a mask and developed, prior to the deposition of the photostructurable coating (4).

(57) Abrégé : Une microstructure comporte une couche d'adhérence (1) entre un substrat (2) et une couche photostructurable (4), disposée sur au moins une face du substrat (2). La couche d'adhérence (1) est photosensible et elle est constituée par une résine négative comportant au moins un polymère de la famille des élastomères et au moins un composant photo-amorceur, en solution dans un solvant aromatique. La couche photostructurable (4) est constituée par au moins une résine négative de type époxy. Le procédé de fabrication d'une telle microstructure comporte l'étalement et le séchage de la couche d'adhérence (1) avant le dépôt de la couche photostructurable (4). La couche d'adhérence (1) peut être insolée à travers un masque et développée, avant le dépôt de la couche photostructurable (4).